

	裕资本、君和资本、才华资本、上海道翼投资、浩成资管、瑞士信贷(香港)、中国平安养老保险、鼎和财保、上海复星、首盛资本、东吴证券(香港)金融、广西赢舟管理咨询、瑞银香港分行、花旗环球、建行、招银理财、信银理财、建信金融、杭银理财、苏银理财、Marco Polo Fund、Torito Capital、中泰证券、东吴证券、信达证券、国联证券、平安证券、长城证券、中信证券、山西证券、中信建投证券、中金公司、方正证券、西部证券、西南证券、兴业证券、德邦证券、浙商证券、海通证券、华泰证券、财通证券、汇丰前海证券、万和证券、野村东方国际证券、东北证券、申银万国、首创证券、民生证券、甬兴证券、长江证券、国海证券、东海证券、华兴证券、东兴证券、国融证券、银河证券、华融证券、国新证券、天风证券、平安证券、开源证券、安信证券、华创证券、个人投资者(排名不分先后)
时间	2023年10月27日10:00
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书: 蒋威 证券投资部: 王渝、陈小曼、陈卓璜
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司2023年第三季度经营情况介绍</p> <p>从行业需求看,2023年第三季度PCB行业景气度有所恢复,但回暖幅度较小,没有明显改善。</p> <p>公司第三季度经营业绩环比有所好转:营收实现14.23亿元、同比略降2.3%,归母净利润1.72亿元、同比增加8.43%,其中,出售Harbor Electronics, Inc.100%股权共获得1.46亿元的处置收益。扣非归母净利润0.27亿元、同比下降78.96%、环比增长399%。</p> <p>二、FCBGA封装基板项目的进展情况</p> <p>珠海FCBGA封装基板项目拟建设产能200万颗/月(约6,000平方米/月)的产线,已于2022年12月底建成并成功试产。部分大客户的技术评级、体系认证均已通过,等待产品认证结束之后进入小批量生产阶段。公司目前已与多家芯片设计公司、封装厂建立了联系,正争取导入批量订单。</p> <p>广州FCBGA封装基板项目拟分期建设2,000万颗/月(2万平方米/月)的产线,一期厂房已于2022年9月完成厂房封顶,目前处于设备安</p>

装、调试阶段，预计今年第四季度完成产线建设，开始试产。

三、FCBGA 封装基板从试产到量产过程良率的变化趋势

FCBGA 封装基板从试产、小批量生产到大批量生产，良率是可能会有所波动的。但从目前看，我们在试产过程中，影响良率的绝大多数核心问题均已遇到并寻求了解决方案，FCBGA 封装基板现阶段试产的良率水平保持相对稳定，因此即便进入批量生产后良率有所反复，相信我们团队也应该能够解决。

四、公司 CSP 封装基板项目情况及少数股东退出的影响

公司 CSP 封装基板现有产能为 3.5 万平方米/月，其中广州基地产能为 2 万平方米/月，已接近满产；广州兴科珠海基地产能为 1.5 万平方米/月，产能利用率超过 50%。得益于行业需求逐步回暖，CSP 封装基板产能利用率逐季提升。

广州兴科少数股东科学城（广州）投资集团有限公司及国家集成电路产业投资基金股份有限公司拟按照协议约定行使退出权，目前各方正积极洽谈具体退出方案及相关安排。广州兴科少数股东退出不会导致公司合并报表范围发生变化，不影响公司的正常生产经营。

五、公司测试板业务的发展规划

测试板业务与样板业务经营模式类似，属于多品种、小批量、定制化生产模式，产品单价和附加值较高。目前国内参与企业较少，公司半导体测试板业务在国内规模领先，目标是建设国内最大的专业化测试板工厂。目前广州基地半导体测试板已建成 2,000 平方米/月的产能，正处于产能爬坡阶段，产品良率、交期、技术能力等稳步提升、持续改善。公司测试板近期无扩产计划。

六、北京兴斐电子有限公司目前的经营情况

北京兴斐电子有限公司已于 2023 年 7 月纳入公司合并报表范围，其专注于面向移动通讯用印制电路板产品，以高性能微小导孔和微细线路的高密度互连电路板（普通 HDI 和 Anylayer HDI）为主要产品，为国内外主流手机厂商的稳定供应商之一，目前各项业务正常开展，第三季度表现良好，已为公司贡献正向收益。

七、公司怎么看待国产化趋势

传统 PCB 业务已实现国产化。

	<p>半导体行业国产化替代的趋势也是毋庸置疑的，前期替代速度慢主要是因为整个产业能力水平尚无法与国外相抗衡，预计需要 1-2 代产品迭代的时间来成长。</p> <p>目前公司也正配合大客户验证部分国产设备、材料，CSP 封装基板项目的国产化率比 FCBGA 封装基板项目的会相对更高一些，但核心设备、材料基本仍是进口的，一方面是客户验证的原因，另一方面是国产设备、材料确实还存在差距，随着整个产业链能力的逐步提升及突破，行业国产化替代占比会逐步提升。</p>
附件清单	无
日期	2023 年 10 月 27 日